

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F flach,
Art. Nr. 110-66025

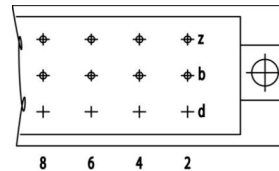
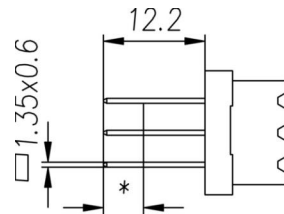


Abbildung ähnlich



Parallel



Rechtwinklig



Einpresstechnik



Power



Rugged

- Anschlusslänge 12.2 mm
- mit Steckzone in Gütestufe 2
- Polzahl 32
- Einpresstechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe [DIN 41612](#)

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F flach,
Art. Nr. 110-66025



Technische Daten

Grundlagen

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Spezifikation | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
| Gütestufe | 2 |
| Anzahl Kontakte | 32 |
| Anschluss technik | Einpresstechnik |
| Anschlusslänge | 12.2 mm |
| Leiterplattenabstand | 24.4 mm |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |

Material

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Isolierkörper | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
| CTI Wert <i>IEC 60112</i> | 200 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |

Mechanisch

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Rastermaß | 5.08 x 3.81 mm |
| Steckkraft | < 50 N |
| Ziehkraft pro Kontakt | >0.2 N |
| Lebensdauer | 400 Steckzyklen |

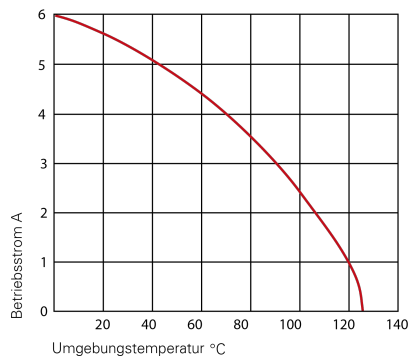
Elektrisch

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Betriebsstrom | 5.6 A |
| Durchgangswiderstand | < 15 mΩ |
| Luft- und Kriechstrecke | K: ≥ 3.0 mm, L: ≥ 1.6 mm |
| Isolationswiderstand | > 10 ⁶ MΩ |
| Prüfspannung | 1550 V |

Zulassungen / Konformität

| | |
|---------|--------------|
| UL file | E130314 |
| Umwelt | RoHS konform |

Derating Diagramm



Bauform D, E, F, G

| | |
|--------|-------|
| 20 °C | 5,6 A |
| 70 °C | 4,0 A |
| 100 °C | 2,5 A |

Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



| Material | chem. Sn Leiterplatten |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nennloch | Ø 1.6 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.75 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|-----------------------------|---|
| Nennloch | Ø 1.6 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.75 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | rein Cu Leiterplatten |
|-----------------------------|--|
| Nennloch | Ø 1.6 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.75 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |

| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennloch | Ø 1.6 mm |
| A Leiterplattendicke | min 1.44 mm |
| B Endloch | Ø 1.6 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.75 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |

Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform F flach,
Art. Nr. 110-66025



Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge für Anschlüsse
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter sales@ept.de